

RJ45C5 R1D 3.3E4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



本製品のラインナップは、下記設計を網羅しています：

- 90アングル（水平）および180ストレート（垂直）
- ラッチアップ/ラッチダウン
- THT、THR、SMDはんだプロセス
- 幅広いデザインタイプ、LED内蔵、シールドタブ付き
- パフォーマンスカテゴリ3 から Cat. Cat.6。
- トレイ包装（TY）またはテープ・オン・リール（RL）
- ANSI / TIA-1096-AおよびIEC 60603に準拠したモジュラーRJ45コネクタに対応
- 絶縁耐力 ≥ 1500 V AC RMS（2250 V ACピーク値）、IEEE 802.3準拠
- IEC 60603に準拠した絶縁耐力 ≥ 1500 V AC（ピーク値）または ≥ 1500 V DC

特性と長所：

- 最大性能に対応する - 40°C から + 85°C の温度範囲拡張
- 30 μ m 金メッキで耐腐食性を強化
- 0.3mm 以上のスタンドオフによる最適なはんだ付け加工

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, RJ45ジャック, Cat. 5, THT/THRはんだ接続, 90°, ラッチオプション: 下部, シールドタブ: 6 tabs, 30...80 μ m Ni / ≥ 30 μ m Au, LED: いいえ, 極数: 8, Tape
注文番号	2562910000
種別	RJ45C5 R1D 3.3E4N RL
GTIN (EAN)	4050118571936
数量	200 Stück
パッケージ	Tape

RJ45C5 R1D 3.3E4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	21.3 mm	奥行き (インチ)	0.839 inch
高さ	17.06 mm	高さ (インチ)	0.672 inch
下位バージョンの高さ	13.76 mm	幅	15.7 mm
幅 (インチ)	0.618 inch	正味重量	4.575 g

システム仕様

LED	いいえ	
PCB の取り付け	THT/THRはんだ接続	
はんだピン位置の公差	0.1 mm	
はんだピン寸法	八角形	
はんだ付け工程	リフローハンダ付け, 手動はんだ付け, フローはんだ付け	
カテゴリー	Cat. 5	
シールド	はい	
シールドタブ	6 tabs	
シールド材質	真鍮	
シールド面	ニッケルメッキ	
ソルダーアイレット穴直径 (D)	0.9 mm	
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)	±0.1 mm	
ソルダーピン長 (l)	3.3 mm	
ソルダーピン長 公差	接頭部の下限公差（最小値表示）	-0.5
	プレフィックス付き上限公差（最大値を表示）	+0.5
	公差、単位	mm
ソルダーピン長 公差	+0.5 / -0.5 mm	
ピッチ (mm) (P)	1.27 mm	
ピッチ (インチ) (P)	0.05 "	
プラグイング回数	750	
ラッチオプション	下部	
保護度合い	IP20	
外向きエルボ	90°	
性能カテゴリ	Cat. 5	
接続方式	はんだ接続	
極当たりソルダーピン数	1	
極数	8	
製品ファミリー	データの最小化 - RJ45モジュージャック	
配線	8コア	

標準

コネクタ規格	IEC 60603-7-51
--------	----------------

電気プロパティ

PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合	定格電圧	125 V
定格電流	1.5 A	絶縁耐性	≥ 500 MΩ
耐電圧、接点 / シールド	1500 V DC	耐電圧、接点 / 接点	1000 V DC

RJ45C5 R1D 3.3E4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

材料データ

絶縁材	PA 9T	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	II
比較追跡指数 (CTI)	≥ 500	絶縁耐性	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 可燃性等級	V-0
接点ベース素材	リン青銅	接点材質	銅合金
接触表面	ニッケル下地金メッキ	プラグ接点の層構造	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	85 °C
動作温度、最小	-40 °C	動作温度、最大	85 °C

梱包

パッケージ	Tape	VPE 長	330 mm
VPE幅	330 mm	VPEの高さ	58 mm
テープリール径φ (A)	330 mm	表面抵抗	Rs = 10 ⁹ - 10 ¹² Ω

分類

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Certificate of Compliance
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

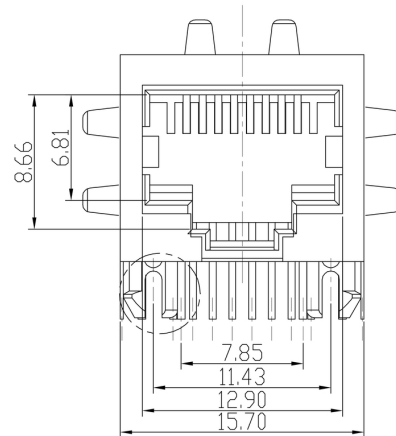
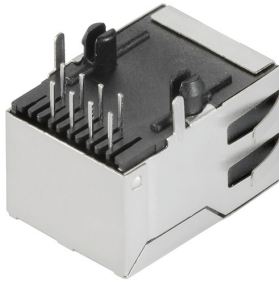
RJ45C5 R1D 3.3E4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

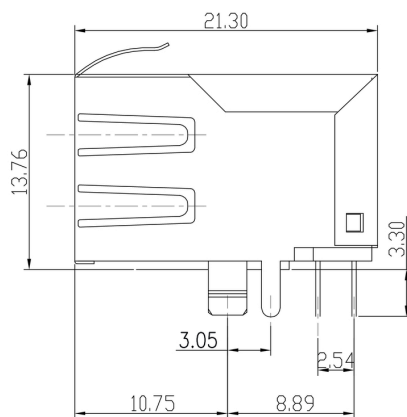
www.weidmueller.com

四面

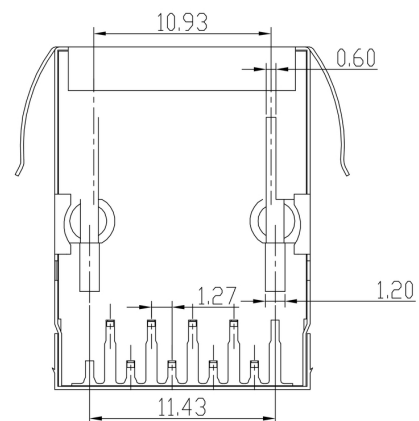
寸法図



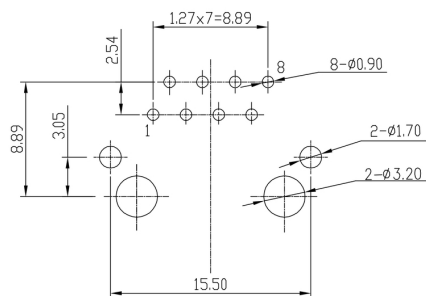
寸法図



寸法図



PCB設計



PCB LAYOUT

作成日 2024/07/04 7:10:15 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

RJ45C5 R1D 3.3E4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

RJ45	G1	R	1	U	3.2	E	4	GY/GY	TY	RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY
										Packaging
										TY
										RL
										Tray in box (manual assembly)
										Tape on Reel (automated assembly)
										LED
										Y/G
										Green/Yellow (standard)
										GY/GY
										Green/Yellow/Green-Yellow
										O/G
										Orange/Green
										R/O
										Red/Orange
										...
										(further combinations possible)
										N
										without LED
										Contact surface thickness
										4
										1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
										EMI tabs (ground fingers)
										E
										E = with EMI tabs
										N
										N = without EMI tabs
										Solder Pin length
										3.2
										3.2 mm
										1.6
										1.6 mm
										D
										SMD
										Direction, latch style
										U
										Horizontal (90°, side entry), latch up
										D
										Horizontal (90°, side entry), latch down
										V
										Vertical (180°, top entry)
										Y
										Diagonal (45°), latch up
										Number of Ports
										1
										1 Port
										12; 14; ...
										multi ports side by side, Multiport
										21; 41; ...
										multi ports about each other, Multilevel
										Assembly on PCB
										R
										Through Hole Reflow - TH-R
										Soldering process: Wave or Reflow soldering
										S
										Surface Mount Technology - SMT
										Soldering process: Reflow soldering
										T
										Through Hole Technology - THT
										Soldering process: Wave
										Performance Category
										C5
										Category 5
										C6
										Category 6
										C6A
										Category 6A
										C5e
										Category 5e
										M
										10/100 Mbit
										G1
										10/100/1000 Mbit
										G10
										10 Gbit
										U
										Unshielded
										MP
										10/100 Mbit with POE
										MP+
										10/100 Mbit with POE+

凡例

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.